

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2008

GESCHÄFTSBERICHT 2007 KURZFASSUNG

ERFOLG HAT DREI BUCHSTABEN



Inhalt

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Tagesordnung	4
Bericht des Vorstands	6
Teilnahme an der Hauptversammlung	7
Hinweise	8
Wegbeschreibung	9

GESCHÄFTSBERICHT 2007 KURZFASSUNG

Überblick	10
Brief des Vorstandsvorsitzenden	11
Konzernlagebericht Auszug	16
Geschäft und Rahmenbedingungen	16
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Auszug	27
Prognosebericht	32
Konzernabschluss Auszug	34



Printdokument
zum Bestellen



Internetverweis
www.elmos.de

9. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG AM 8. MAI 2008

Tagesordnung auf einen Blick

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts des Vorstands für die ELMOS Semiconductor AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (10% des Grundkapitals)

ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
44227 Dortmund
ISIN DE0005677108
Wertpapier-Kenn-Nummer: 567 710

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Einladung zur 9. Ordentlichen Hauptversammlung der ELMOS Semiconductor AG, 44227 Dortmund (ISIN DE0005677108 / Wertpapier-Kenn-Nummer: 567 710)

Sehr geehrte Aktionäre,

unsere 9. Ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 8. Mai 2008, um 10.00 Uhr im Casino Hohensyburg, Hohensyburgstraße 200 in 44265 Dortmund, statt.

Tagesordnung

1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts des Vorstands für die ELMOS Semiconductor AG und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bei der ELMOS Semiconductor AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von 39.621.311,85 Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Diese Ermächtigung ist bis zum 9. November 2008 befristet. Es wird vorgeschlagen, diesen Beschluss aufzuheben und den Vorstand erneut zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft zu ermächtigen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

- a) Die auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 bestehende und bis zum 9. November 2008 befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der nachstehenden neuen Ermächtigung aufgehoben.
- b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 7. November 2009 eigene Aktien zu erwerben.
- c) Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.
- d) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebotes.
 - Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Eröffnungskurs am Erwerbstag im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten.

- ▶ Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der letzten drei Börsentage vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebotes um nicht mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen werden.
- e) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, zu den nachfolgenden Zwecken zu verwenden:
 - aa) Sie können an Führungskräfte und Mitarbeiter der ELMOS Semiconductor AG sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter verbundener Unternehmen im Rahmen der Aktienoptionspläne 1999 und 2004 in Erfüllung der Aktienbezugsrechte übertragen werden. Soweit eigene Aktien Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft in diesem Rahmen übertragen werden sollen, wird der Aufsichtsrat der Gesellschaft hierzu ermächtigt. Dabei werden die Regelungen der bestehenden Aktienoptionspläne 1999 und 2004 angewandt: Die von der Hauptversammlung beschlossenen Eckpunkte der Aktienoptionspläne 1999 und 2004 liegen als Bestandteile der notariellen Niederschriften über die entsprechenden Hauptversammlungen bei dem Handelsregister in Dortmund zur Einsicht aus. Sie können außerdem in den Geschäftsräumen und am Sitz der ELMOS Semiconductor AG, Heinrich-Hertz-Str. 1, 44227 Dortmund, sowie im Internet unter <http://www.elmos.de/investor-relations/corporate-governance/options-programm.html> eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt und liegen während der Hauptversammlung aus.
 - bb) Sie können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere um sie Dritten beim Zusammenschluss mit Unternehmen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern anzubieten.
 - cc) Sie können Führungskräften und Mitarbeitern der ELMOS Semiconductor AG, Mitgliedern der Geschäftsführungen und Mitarbeitern verbundener Unternehmen und freien Mitarbeitern zum auch kostenlosen Erwerb angeboten und übertragen werden.
 - dd) Sie können durch den Aufsichtsrat den Mitgliedern des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG unter Wahrung des Gebots der Angemessenheit der Vergütung (§ 87 Abs. 1 AktG) als aktienbasierter Vergütungsbestandteil zugesagt und übertragen werden. Die Einzelheiten der aktienbasierten Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt.
 - ee) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Aufsichtsrat gem. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG ermächtigt, die Zahl der Stückaktien in der Satzung anzupassen.
- f) Ein Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gem. den Ermächtigungen in lit. e), aa), bb), cc) und dd) verwendet werden.

Bericht des Vorstands zur Hauptversammlung am 8. Mai 2008

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Hauptversammlungen zum Aktienrückkauf und zur anschließenden Veräußerung erworbener eigener Aktien ermächtigende Beschlüsse gefasst, deren letzter bis zum 9. November 2008 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung im laufenden Geschäftsjahr soll mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag die derzeit bestehende Ermächtigung ersetzt werden, die von der Hauptversammlung am 10. Mai 2007 beschlossen wurde.

Dabei soll die Gesellschaft neben dem Erwerb über die Börse auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung im Verhältnis der angebotenen Aktien erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Die ELMOS-Aktienoptionspläne 1999 und 2004 für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der ELMOS Semiconductor AG sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter verbundener Unternehmen werden jeweils durch ein bedingtes Kapital abgesichert. Der unter Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene Beschluss soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, die Aktienoptionspläne 1999 und 2004 auch durch den vorherigen Erwerb eigener Aktien zu bedienen. Damit wird insbesondere eine Verwässerung der Altaktionäre durch die ansonsten erforderliche Kapitalerhöhung vermieden. Die Entscheidung darüber, wie die Optionen im Einzel-

fall erfüllt werden, treffen die zuständigen Organe der Gesellschaft; sie werden sich dabei allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen und in der jeweils nächsten Hauptversammlung über ihre Entscheidung berichten.

Der Gesellschaft soll durch die eingeräumte Ermächtigung die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese gegen Sachleistung veräußern zu können, insbesondere als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen. Der nationale und internationale Wettbewerb sowie die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Er wird sich in der Regel, wenn er den Wert der als Gegenleistung hingeggebenen Aktien bemisst, am Börsenkurs der ELMOS Semiconductor AG-Aktie orientieren. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien an Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen, freie Mitarbeiter sowie Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft anzubieten und zu übertragen. Durch die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens soll eine zusätzliche Form der aktienbasierten Vergütung geschaffen werden, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden bzw. qualifizierte neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Die Ziele der Motivation und Bindung der Mitarbeiter des Unternehmens liegen im Interesse der Gesellschaft. Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung erworbener eigener Aktien ist hierfür Voraussetzung. Auch Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen die Möglichkeit erhalten, vom Aufsichtsrat Aktien als aktienbasierte Vergütung zugesagt oder übertragen zu bekommen. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Vergütungsbestandteil auch

an Vorstandsmitglieder zusagen oder übertragen zu können, bindet die Mitglieder des Vorstands an das Unternehmen und dessen wirtschaftlichen Erfolg und liegt somit ebenfalls im Interesse der Gesellschaft. Die Mitglieder des Vorstands, die Aktien auf dieser Grundlage als Vergütung erhalten, haben ein zusätzliches Interesse daran, auf die Wertsteigerung der Gesellschaft, ausgedrückt im Börsenkurs, hinzuwirken. Sie tragen jedoch auch das Kursrisiko. Die Entscheidung hierüber obliegt allein dem Aufsichtsrat als zuständigem Entscheidungsorgan, das auch über die Modalitäten der aktienbasierten Vergütung an Vorstandsmitglieder unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Angemessenheit (§ 87 Abs. 1 AktG) befindet. Hierdurch ist sichergestellt, dass das Bezugsrecht der Aktionäre nicht übermäßig und nur im Interesse der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

Die aufgrund des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können. Die Hauptversammlung kann gem. § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die Einziehung von Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht diese Alternative neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital. Der Aufsichtsrat soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der Stückaktien, die sich durch die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger 19.414.205,00 Euro und ist eingeteilt in 19.414.205 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesellschaft hält 50.000 eigene Aktien, so dass zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger die Gesamtzahl der Aktien 19.414.205 und die der Stimmrechte an der Gesellschaft 19.364.205 beträgt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §11 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln:

ELMOS Semiconductor AG
c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
60272 Frankfurt am Main

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 17. April 2008 beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 30. April 2008 unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären wie bisher an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Hinweise

Aktionäre, die von der Möglichkeit der Vollmachtserteilung Gebrauch machen wollen, benötigen dazu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter www.elmos.de einsehbar.

ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET

Alle Aktionäre der ELMOS Semiconductor AG sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Hauptversammlung auf Anordnung des Versammlungsleiters am 8. Mai 2008 ab 10.00 Uhr in voller Länge live im Internet verfolgen (www.elmos.de). Der uneingeschränkte Onlinezugang zur Live-Übertragung wird unter Investor Relations/Hauptversammlung ermöglicht.

ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN

Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten:

Hauptversammlungsstelle
ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund
Telefax: +49 (0)231/7549-548

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Bis spätestens zum Ablauf des 23. April 2008 unter vorstehender Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärserschaft des Antragstellers den anderen Aktionären im Internet unter www.elmos.de unverzüglich zugänglich gemacht. Sofern sie auch in englischer Sprache veröffentlicht werden sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 23. April 2008 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Dortmund, im März 2008

Der Vorstand

EINLASS

Der Einlass zur Hauptversammlung ist am 8. Mai 2008 ab 9.00 Uhr geöffnet.

PARKMÖGLICHKEITEN

Während der Hauptversammlung stehen für unsere Besucher Parkplätze am Casino Hohensyburg zur Verfügung. Wir bitten Sie, die Parkscheine bei der Anmeldung vorzulegen, damit wir sie gegen Parkgutscheine austauschen können, die es Ihnen ermöglichen, kostenlos zu parken.

BUS-TRANSFER VOM/ZUM BUSBAHNHOF DORTMUND

Am Busbahnhof Dortmund – gegenüber des Hauptbahnhofes – steht um 9.00 Uhr ein kostenloser Bus-Transfer der Firma Horn-Reisen zu unserer Hauptversammlung im Casino Hohensyburg zur Verfügung. Dieser Bus fährt um 13.00 Uhr vom Casino Hohensyburg zurück zum Busbahnhof Dortmund.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Ab 14.03 Uhr fährt der Casinobus stündlich ab dem Casino Hohensyburg zum Busbahnhof nach Dortmund.

Wegbeschreibung



A1 aus Richtung Köln kommend Ausfahrt Hagen Nord. Von dort ist der Weg zum Casino Hohensyburg ausgeschildert.

Von der A44 oder A2 kommend zuerst Richtung Dortmund Zentrum. Von der Innenstadt über die B54 Richtung Süden zum Casino Hohensyburg.

Von der A45 kommend die Ausfahrt Dortmund Süd Richtung Hohensyburg nehmen. Ab der Ausfahrt ist das Casino Hohensyburg ausgeschildert.

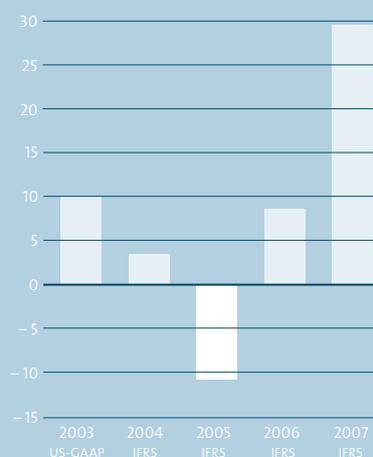
Fünfjahresübersicht ELMOS-Konzern

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	2003	2004	2005	2006	2007	2007***
	US-GAAP	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Umsatz	121,4	143,3	147,0	160,7	176,1	176,1
Umsatzwachstum	10,7%	18,1%	2,6%	9,3%	9,6%	9,6%
Bruttoergebnis	61,4	73,2	70,6	73,0	73,1	76,9
Bruttomarge	50,6%	51,1%	48,1%	45,5%	41,5%	43,6%
Forschungs- & Entwicklungskosten	20,4	24,7	28,1	29,6	30,9	30,7
Forschungs- & Entwicklungskosten in % vom Umsatz	16,8%	17,2%	19,1%	18,4%	17,5%	17,5%
EBIT	21,1	26,4	20,0	19,8	15,2	20,9
EBIT in % des Umsatzes	17,4%	18,4%	13,6%	12,3%	8,6%	11,8%
Ergebnis vor Steuern	17,3	22,9	16,4	17,3	12,2	17,9
Ergebnis vor Steuern in % des Umsatzes	14,2%	16,0%	11,2%	10,8%	6,9%	10,2%
Jahresüberschuss	10,0	14,2	10,0	10,7	8,8	12,5
Nettogewinnmarge	8,3%	9,9%	6,8%	6,7%	5,0%	7,1%
Ergebnis je Aktie in Euro	0,52	0,74	0,52	0,55	0,45	0,64
Bilanzsumme						
	205,3	217,3	237,0	245,3	249,3	
Eigenkapital						
	124,7	133,8	144,3	152,3	160,0	
Eigenkapitalquote						
	60,7%	61,6%	60,9%	62,1%	64,2%	
Finanzverbindlichkeiten						
	60,6	57,6	67,9	65,0	54,0	
Liquide Mittel und Wertpapiere						
	25,9	18,9	16,8	16,6	42,9	
Nettoverschuldung						
	34,7	38,7	51,2	48,4	11,1	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit						
	6,5	34,7	19,7	28,5	30,8	
Investitionen in das Anlagevermögen						
	-25,3	-33,5	-29,6	-26,4	-24,5	
Investitionen in % vom Umsatz						
	20,9%	23,4%	20,1%	16,4%	13,9%	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit						
	3,4	-31,2	-30,4	-19,9	-1,4	
Free Cash Flow*						
	10,0	3,5	-10,7	8,6	29,4	
Dividende je Aktie in Euro						
	0,13	0,21	0,00	0,00	0,00**	
Mitarbeiter im Jahresmittel						
	874	928	1.028	1.131	1.177	

Umsatz in Mio. Euro und Wachstum



Free Cash Flow* in Mio. Euro



* Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2008

*** Von Einmaleffekten (aus der Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften) bereinigt

Vorstand

Brief des Vorstandsvorsitzenden

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die ELMOS kann auf ein insgesamt positives Jahr 2007 zurückblicken. Wir haben wesentliche wirtschaftliche Ziele erreicht, neue Kunden gewonnen und bestehende Kundenbeziehungen gestärkt. Unsere strategische Ausrichtung haben wir durch wichtige Entscheidungen und operative Ergebnisse in der Umsetzung nach vorn gebracht. Erfreulich war besonders, dass wir unser Wachstumsziel von rund 10% erreicht haben.

Im vergangenen Jahr haben wir unseren Umsatz um 9,6% auf 176,1 Mio. Euro steigern können. Das ist umso bemerkenswerter, als das Berichtsjahr zum einen durch die Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften beginnend im ersten Quartal, zum anderen durch die schwierigen Marktbedingungen insbesondere im Inland und in den USA gekennzeichnet war. Wie berichtet, führte die Restrukturierung bei unserer Tochter SMI in Kalifornien und der Niederlassung in den Niederlanden zu Sonderaufwendungen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. Euro. Auf Seiten des Marktes war zu vermerken, dass der Automobilsektor in Westeuropa, vor allem in Deutschland, und in den USA schwach war. Die Gründe dafür sind vielfältig: so hat der Ölpreis in 2007 neue Rekordmarken erreicht und die in den USA ausgelöste Kreditkrise das Konsumverhalten beeinflusst. Des Weiteren hat der schwache Dollarkurs die Umsatzerlöse im US-Dollar-Raum gemindert. Dennoch konnten einige deutsche Automobilhersteller signifikante Erfolge im Export erzielen.

Viele in unserem Segment tätige Marktteilnehmer mussten ihre Umsatz- und Ergebniserwartungen aufgrund der Marktbedingungen zum Ende des Jahres teilweise erheblich korrigieren. Dagegen konnte ELMOS das Umsatzziel, sowie die nach Sondermaßnahmen Anfang des Jahres angepasste Ergebnis-Prognose erreichen. Dies ist ein Zeichen für das große Vertrauen der Kunden in unsere Produkte und eine Bestätigung für unseren Produktmix, der auch in schwierigen Zeiten solides Wachstum sicherstellt.

Ohne Sondereffekte aus Restrukturierung belief sich das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) auf 20,9 Mio. Euro oder 11,8% vom Umsatz. Dies entspricht einem Anstieg von 5,3%. Der Jahresüberschuss steigerte sich um 16,4% auf 12,5 Mio. Euro. In Prozent vom Umsatz haben wir ein Niveau von 7,1 erreicht. Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte haben wir also unsere Ziele weitestgehend erreicht, besonders gestützt durch eine starke Leistung im Kerngeschäft, dem Halbleiter-Bereich.

Unter Berücksichtigung der Sondereffekte erreichte das EBIT 15,2 Mio. Euro oder 8,6% vom Umsatz. Der Jahresüberschuss betrug 8,8 Mio. Euro oder 5,0% vom Umsatz.

Erfreulich ist auch, dass wir den Free Cash Flow deutlich auf 29,4 Mio. Euro steigern konnten. Dies ist das Ergebnis des auf 30,8 Mio. Euro gestiegenen operativen Cash Flows, signifikanter Barmittelzuflüsse aus Veräußerungen und maßvoller Investitionen, trotz des weiteren Ausbaus der Fertigungskapazitäten. Erwähnt sein soll an dieser Stelle auch, dass wir in 2007 den Großteil der kurzfristigen Darlehen langfristig umfinanziert haben, und zwar bevor die ersten Anzeichen der Kreditkrise in den USA diskutiert wurden. Wir haben also die Finanzlage der Gesellschaft strukturell deutlich gestärkt.

Trotz der positiven Entwicklung beim Cash Flow veranlassen uns die aufgrund der Sonderbelastungen aus Restrukturierungen reduzierten Ergebnisse auch in diesem Jahr, der Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Wir bleiben bei unserer Feststellung der letzten Jahre, dass die Gesellschaft nur dann eine Dividende zahlen sollte, wenn Ergebnisentwicklung und Cash Flow nachhaltig positiv sind.

Mit der Entwicklung unseres Aktienkurses im Berichtsjahr können wir nicht zufrieden sein. Auch wenn wir besser als der Halbleiterindex SOX und die Wettbewerber abgeschnitten haben, hat die ELMOS-Aktie in 2007 immer noch 3% an Wert verloren und das Jahr mit 7,35 Euro beendet.

Wie in den Vorjahren haben wir auch 2007 bedeutende Themen strategischer und operativer Natur erfolgreich weitergeführt, wichtige Meilensteine erreicht bzw. eingeleitete Programme positiv abgeschlossen. Besonders hervorheben möchte ich:

- ▶ Der Ausbau unserer starken Position im automobilen ASIC-Markt ist unverändert die intakte Wachstumssäule unseres Geschäfts. So haben wir ASIC-Folgeaufträge gewonnen, ohne dabei den branchenüblichen Vergabeprozess durchlaufen zu müssen. Wir haben unsere Kunden mit unseren kosteneffizienten Lösungen, der ausgezeichneten Qualität und ebensolcher Liefertreue sowie unserer Entwicklungskompetenz überzeugt, so dass die Entscheidung für ELMOS aus ihrer Sicht außer Frage stand. Damit hat sich auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden verbessert.
- ▶ Wir haben es als erstes Unternehmen weltweit geschafft, einen FlexRay™-Sternkoppler zu entwickeln und zur Serienreife zu bringen. Damit belegen wir in diesem zukunftsweisenden Markt der Bussysteme weltweit eine führende Rolle. Dieser Halbleiter hat in 2007 die Freigabe von BMW erhalten. Dies ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit und Lösungskompetenz unserer Entwicklung. FlexRay™-Bussysteme werden mittelfristig in vielen Anwendungen CAN-Bussysteme ablösen. Das Bussystem CAN ist das derzeit Stückzahl-stärkste Netzwerk im Auto. ELMOS ist bisher in CAN-Systemen unterrepräsentiert, so dass wir uns mit den FlexRay™-Aktivitäten ein großes zukünftiges Wachstumsfeld erschließen.

- ▶ Die Verlagerung des Standardgehäuse-Assemblys nach Fernost ist seit Mitte des vergangenen Jahres abgeschlossen. Das hat mehrere Vorteile: unsere Assembly-Produktion in den Niederlanden kann sich nun vollkommen auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren. Wir reduzieren mit diesem Schritt mittel- und langfristige Investitionen und steigern den Zukauf aus dem US-Dollar-Raum. Die Struktur unseres Standortes in den Niederlanden haben wir entsprechend angepasst.
- ▶ Wir haben unsere Distributoren-Basis in Europa und Asien deutlich erweitert. Insgesamt hat die EL MOS-Gruppe mit zehn neuen Distributoren Verträge unterzeichnet. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Aufträgen in den Bereichen Automobil-, Industrie- und Konsumgüterelektronik sowie der Medizintechnik.
- ▶ Die applikationsspezifischen Standardprodukte (ASSPs) sind im vergangenen Jahr zu einer festen Größe im Konzern herangewachsen. Ein Beispiel dafür ist das umfangreiche Portfolio an Produkten, welche unsere Kernkompetenzen in den Bereichen „Sense“, „Drive“, „Connect“ und „Supply“ herausstellt. Wir setzen bei unseren ASSPs auf unser Know-how und überzeugen die Kunden durch eigene, patentierte Lösungen. Unsere Entwicklung arbeitet an wesentlichen Neuerungen: Im Bereich „Sense“ bieten wir in nächster Zeit neue Sensorelemente, Sensorauswertechips und Mikrosysteme für verschiedene physikalische Messgrößen an. Unsere Investition in das EL MOS-eigene VirtuHall® Prinzip zur effizienten Ansteuerung von EC-Motoren schlägt sich in einer IC-Familie für den Bereich „Drive“ mit Derivaten nieder. Für die Produktgruppe „Connect“ stehen neben den schon erwähnten FlexRay™-Transceivern bald weitere standardisierte Bus-ICs zur Verfügung, die sowohl im Auto als auch in der Industrie vermehrt eingesetzt werden. Für die Applikationsgruppe „Supply“ werden aktuell Schaltungskonzepte mit hocheffizienten DC/DC-Wandlern in die Tat umgesetzt, die z.B. für LED-Beleuchtungen in Fahrzeugen oder in Gebäuden, den Kühlaufwand bei unseren Kunden je nach Applikation bis auf die Hälfte reduzieren werden.
- ▶ Am Standort Milpitas, Kalifornien, USA, arbeiten wir bei unserem dortigen Tochterunternehmen Silicon Microstructures Inc. (SMI) seit Anfang 2007 mit einer neuen Geschäftsführung zusammen. Neben der Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung mit den vorhandenen Produkten wird die Entwicklung neuer Sensorprodukte und Mikrosysteme massiv vorangetrieben. Schwerpunkt ist dabei der Ausbau der Kernkompetenzen im Bereich der „Drucksensoren“. Die Entwicklung für Mikrosysteme erfolgt standortübergreifend zwischen unseren Tochtergesellschaften in Milpitas, und Nijmegen sowie unserem Hauptsitz Dortmund.

- ▶ Unser neuer Fertigungsstandort für 8-Zoll-Wafer in Duisburg hat 2007 die Kapazitäten kontinuierlich erhöht. Nach einem planmäßigen Verlauf über drei Quartale mussten wir in der zweiten Hälfte des letzten Quartals die weitere Steigerung der Wafereinstellung aussetzen. Im Sinne von Qualität und Stabilität von Produkten und Prozessen haben wir uns für diese Maßnahme entschieden. Die dadurch verursachte Verzögerung im Kapazitätsaufbau in Duisburg wird zu keiner Verschiebung der geplanten, teilweisen Umrüstung von 6- auf 8-Zoll-Wafern in Dortmund führen. Dies wird durch entsprechende Sondermaßnahmen sichergestellt.
- ▶ Anfang 2008 konnten wir mit einem Partner in Asien einen Kooperationsvertrag zur Auftragsfertigung unterzeichnen. Wir werden zusammen mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip auch eine neue Technologie-Generation entwickeln und in der Folge fertigungsprozessierte Wafer auch für automobiler Produkte von MagnaChip beziehen. Die dafür notwendigen hohen automobilen Qualitätsstandards wird MagnaChip zuverlässig erfüllen. Wir können dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf sowie unsere Entwicklungsaufwendungen für zukünftige Technologiegenerationen deutlich reduzieren und flexibler auf schwankende Stückzahlen reagieren. Zudem wird dies mittelfristig unsere US-Dollarabhängigkeit reduzieren und den Kapazitätsbedarf für unser Wachstum absichern.
- ▶ In 2007 konnten wir generell gute Erfolge auf dem asiatischen Markt erzielen. Wir haben zum Beispiel den Auftrag eines großen japanischen Elektronikkonzerns gewonnen. Die damit realisierbaren berührungslosen Schalter nach dem HALIOS®-Prinzip werden 2008 in erste Applikationen aus dem Konsumgüterbereich verbaut. Unsere Chips dafür werden wir von einer Foundry (Auftragsfertigung) in Taiwan beziehen. Auch in Südkorea haben wir enge Beziehungen zu den dortigen Automobilzulieferern und den Fahrzeugherstellern geknüpft, die kurzfristig zu konkreten Aufträgen führen werden.

Anhand der Beispiele erkennen Sie, dass, nachdem Strategie und Richtung festgelegt waren, in 2007 viele Themen angepackt und umgesetzt wurden. Wir haben nach sorgfältiger Planung und Konzeption das „Tun“ vorangestellt. Das Ziel bleibt: Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit von ELMOS stärken, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Dabei stellen wir insbesondere auch die Verbesserung der Ergebnisqualität in den Vordergrund.

Außerdem wollen wir unsere Führung unter den spezialisierten Halbleiterherstellern ausbauen und zwar in jeder Hinsicht: beim Produktportfolio, in der Qualität und bei der Lösungskompetenz. Dies wollen wir sowohl aus eigener Kraft wie auch – bei entsprechender Gelegenheit – durch Zukauf erreichen.

Dass wir im Kernfeld Automobil erfolgreich unterwegs sind, zeigt sich u.a. an der Statistik des Marktforschungsinstitutes Gartner Dataquest. Hier haben wir in der letzten Erhebung den Sprung vom dritten auf den zweiten Platz der weltweit größten automobilen ASIC-Hersteller geschafft. Mit unserer Unternehmensgröße und unserem Applikations-Know-how sind wir der ideale Partner für die Schlüsseltechnologie Mikroelektronik im Automobilssektor und der Industriebranche sowie generell für mittelständische Unternehmen.

Zum Schluss möchte ich mich herzlich bei allen unseren Partnern bedanken, beginnend bei unseren Kunden. Das entgegengebrachte Vertrauen der Kunden wissen wir sehr zu schätzen. Wir werden jeden Tag mit vollem Engagement daran arbeiten, dieses Vertrauen zu rechtfertigen, die Erwartungen zu übertreffen und ihnen die beste Lösung bei höchster Qualität anzubieten.

Die erreichten Resultate verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ganzen ELMOS-Gruppe. Der Einsatz, das Know-how, der Wille zum Erfolg und die Identifikation mit dem Unternehmen waren herausragend.

Des Weiteren gilt unseren Aktionärinnen und Aktionären mein Dank, die uns trotz wenig erfreulicher Kursentwicklung die Treue halten. Ich bin überzeugt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum bei deutlich reduzierten Investitionen den Unternehmenswert dauerhaft steigern wird.

Für 2008 wollen wir eine Verbesserung auf breiter Front erzielen. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem Wachstum über dem Marktdurchschnitt. Der Umsatz soll zwischen 7% und 9% gesteigert werden. Die EBIT-Marge wird zwischen 12% und 14% erwartet. Die Investitionen sollen geringer als im Vorjahr ausfallen. Darüber hinaus ist wieder ein positiver Free Cash Flow geplant.

Wir haben uns ambitionierte aber erreichbare Ziele gesetzt. Dazu werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und selbstverständlich der gesamte Vorstand ihr Bestes geben, denn: Erfolg hat drei Buchstaben: TUN.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Anton Mindl

Vorsitzender des Vorstands

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS ist weltweit die Nummer 2 bei ASICs für Fahrzeuge

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2007 entfielen rund 90% vom Umsatz auf dieses Marktsegment. Seit ihrer Gründung hat sich ELMOS eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Basierend auf einer Studie des Marktforschungsinstituts Gartner Dataquest aus dem März 2007 wird ELMOS als die weltweite Nummer zwei (Vorjahr Nummer drei) im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt nach STMicroelectronics aufgeführt. Die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor und Melexis folgen auf den Plätzen vier und fünf.

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen sowie zahlreichen amerikanischen und asiatischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf bis acht Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von den geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Industrie- und Konsumgüterbereich rückt stärker in den Fokus

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS zudem im Industrie- und Konsumgüterbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich hat im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund 10% des Umsatzes ausgemacht.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch die kundenspezifische Produktentwicklung und zum anderen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen ausgerichtete Fertigungstechnologie zu überzeugen. So entwickelt ELMOS derzeit noch überwiegend Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für den jeweiligen Kunden.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren. ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang fast ausschließlich in den eigenen Produktionsstätten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg. Sowohl durch die automobilgerechte Hochvolt-CMOS-Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip-Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.



Mikromechanische Bauelemente (MEMS) entwickeln, produzieren und vertreiben wir bei unserer Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI), welche zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium zählt. Mit einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Spezialgehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS AP wurde im Geschäftsjahr 2007 komplett auf kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse ausgerichtet, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden. Neben der konzerninternen Assemblierung fertigt ELMOS AP auch Spezialgehäuse für Drittkunden.

Die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen, realisiert durch ELMOS Microsystems, runden die Produktpalette ab. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Mikrosysteme bestehen aus Halbleiter und Sensor in einem Spezialgehäuse

Strategie

Die Strategie von ELMOS umfasst als Kernelemente den Ausbau der starken Position im automobilen ASIC-Geschäft, den verstärkten Vertrieb von ASSPs zur Ergänzung des existierenden Produkt- und Kundenportfolios, die Vereinbarung von Kooperationen zur Reduzierung der Investitionen und Ergänzung des existierenden Technologie- und Produktportfolios, die Etablierung des Mikrosystem-Geschäfts als Wachstumssäule des Unternehmens sowie die stärkere Bedienung der Konsumgüter- und Industriemärkte. Regional haben wir die Zielsetzung, stärker am Wachstum in Asien zu partizipieren. Im Berichtsjahr konnten wir bei der Umsetzung der Strategie erhebliche Fortschritte erzielen.

Automobiles ASIC-Geschäft

Großes Vertrauen
der Kunden

Der Gewinn von wichtigen Folgeaufträgen für kundenspezifische Halbleiter im Automobil im Jahr 2007 unterstreicht den Ausbau der starken Position im automobilen ASIC-Geschäft. Die Kernkompetenzen im Bereich der effizienten Motoransteuerung für Klimaanlage sowie verschiedene Airbag-ICs standen dabei im Mittelpunkt. Auftraggeber sind u.a. langjährige Kunden aus der Automobilindustrie. Diese Folgeaufträge bestätigen das Vertrauen der Kunden in eigens entwickelte Halbleiterlösungen. Das Volumen der Aufträge stellt das mittelfristige Wachstum der Gesellschaft auf eine solide Basis.

Die Pflege enger Kundenbeziehungen und deren Intensivierung sind für uns nach wie vor von hoher Bedeutung. So haben wir im Berichtsjahr bereits zum wiederholten Mal eine In-house Kundenveranstaltung durchgeführt, bei der zahlreiche Vertreter der Automobilindustrie aktuelle Trends der Fahrzeug-Elektronik präsentierten. Unter dem Motto „Mega-Trends und Nischen: Standardisierung, Modularisierung und Differenzierung durch Elektronik“ haben renommierte Referenten von Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai-Kia, Opel, VW und Tyco Electronics AMP vorgetragen.

ASSPs

Im Jahr 2007 haben wir die Entwicklung und den Vertrieb von Applikations-Standards (ASSPs) stark vorangetrieben. Hierbei fließen insbesondere patentrechtlich geschützte Verfahren wie HALIOS® (High Ambient Light Independent Optical System) und VirtuHall® ein, die für EL MOS und unsere Kunden Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lösungen, z.B. für Sensor- bzw. Antriebsanwendungen.

Kernkompetenzen „Sense“,
„Drive“, „Connect“ und „Supply“

Bei der Entwicklung der ASSPs fokussieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen „Sense“, „Drive“, „Connect“ und „Supply“. Im Bereich „Sense“ entwickeln wir neue Sensorelemente, Sensorauswerte-ICs und Mikrosysteme für verschiedene physikalische Messgrößen. Das EL MOS-eigene VirtuHall® Prinzip zur effizienten Ansteuerung von EC-Motoren schlägt sich in einer ganzen IC-Familie für den Bereich „Drive“ mit verschiedenen Derivaten nieder. Für die Produktgruppe „Connect“ stehen zahlreiche standardisierte Bus-ICs zur Verfügung, die sowohl im Auto als auch in der Industrie vermehrt eingesetzt werden. Für die Applikationsgruppe „Supply“ werden neue Schaltungskonzepte in die Tat umgesetzt, um unseren Kunden hoch effiziente DC/DC-Wandler – beispielsweise für LED-Beleuchtungen in Fahrzeugen oder in Gebäuden – anzubieten. Die Produkte sind für einen Einsatz sowohl in Automobil- wie auch in Industrie- und Konsumgüterapplikationen geeignet.

Weitere im Jahr 2007 durchgeführte Maßnahmen, die den gestiegenen Stellenwert der ASSPs für EL MOS unterstreichen, sind die Verbreiterung der Distributorenbasis, die Neugestaltung der Webseite, die im Produktbereich nun eine Suche nach ASICs oder ASSPs ermöglicht, sowie der neu aufgelegte, mit 64 Produkten auf über 130 Seiten deutlich erweiterte Standard-Produktkatalog.

Kooperationen

Um langfristig ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio anzubieten und gleichzeitig dauerhaft einen positiven Free Cash Flow zu generieren, ist es die Strategie von ELMOS, mit Partnern zu kooperieren und dadurch die eigenen Fähigkeiten sinnvoll zu ergänzen. Dies ermöglicht gleichzeitig eine Reduktion der Investitionen bzw. Entwicklungsaufwendungen für ELMOS.

ELMOS verfolgt sowohl den Ansatz sogenannter Zwei-Chip-Lösungen, bei denen Chips von zwei unterschiedlichen Herstellern in einem Package assembliert werden können, als auch den der Fremdfertigung, bei der i.d.R. große Halbleiterfoundries in von ELMOS nicht angebotenen Technologien nach unseren Konstruktionsplänen produzieren. Beispielsweise haben wir in 2007 mit einer taiwanesischen Foundry funktionsfähige Chips für ein Konsumgüterprodukt realisiert. Darüber hinaus haben wir Anfang 2008 mit einem Partner einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dabei werden wir zusammen mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip einerseits eine neue Technologie entwickeln und andererseits dort fertig prozessierte Wafer beziehen. Wir können dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf reduzieren und flexibler auf stark schwankende Stückzahlen reagieren.

Darüber hinaus haben wir in 2007 unsere seit vielen Jahren bewährten Partnerschaften mit unseren Packaging-Dienstleistern in Südostasien weiter intensiviert. So wurde Mitte 2007 die Verlagerung der Standard-Chip-Verpackungen von ELMOS Advanced Packaging nach Asien abgeschlossen.

Verlagerung der
Standard-Chip-Verpackungen
abgeschlossen

Mikrosysteme

ELMOS ist eines der wenigen Unternehmen, welches komplette Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, vollständig entwickeln und produzieren kann. Mit dieser Fähigkeit hebt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert einen einzigartigen Vorteil.

In 2007 hat der Vorstand bei SMI eine neue Geschäftsführung eingesetzt, um zukünftig die Marktchancen für Mikrosysteme besser und zuverlässiger zu nutzen. Zudem wurde ein Restrukturierungs- und Ergebniskorrekturbedarf für 2007 festgestellt. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Standort in den Niederlanden. Aufgrund von verspäteten SMI-Produktanläufen musste in den Niederlanden die Struktur angepasst werden.

Neue Märkte

Nach der Gründung von ELMOS Industries Ende 2006 wurden in 2007 die Grundlagen dafür geschaffen, dass die nicht-automobilen Märkte, d.h. Industrie- und Konsumgütermärkte, mittelfristig einen Anteil von 20% bis 30% des Gesamtumsatzes ausmachen können.

So sind im Berichtsjahr bereits einige ASIC-Projekte aus dem Bereich der Heizungssteuerung, Industrie-Bus-Applikation, Industriesteuerung, etc. entstanden, die teilweise bereits in Serie produziert und an die Kunden ausgeliefert werden. Weitere ASIC- und ASSP-Projekte werden derzeit mit mehreren Kunden verhandelt, so dass eine deutliche Steigerung des Umsatzes in diesem Segment in den nächsten Jahren erwartet wird.

Auftrag eines großen japanischen Elektronikkonzerns gewonnen

Mit dem Gewinn eines Auftrags von einem großen japanischen Elektronikkonzern konnte im Berichtsjahr ein signifikanter Erfolg auf dem asiatischen nicht-automobilen Markt verzeichnet werden. Das Produkt ist ein neuer Chip basierend auf unserem patentierten HALIOS®-Prinzip, welches u.a. die kontaktlose dreidimensionale Erfassung von Gegenständen oder Bewegungen ermöglicht. Die damit realisierbaren berührungslosen Schalter sollen 2008 in erste Applikationen aus dem Konsumgüterbereich, beispielsweise in Fernbedienungen, MP3-Playern, Telefonen und Computer-Peripheriegeräten, verbaut werden.

Organisationsstruktur

Enge Kunden-Lieferantenbeziehung

Die ELMOS-Struktur orientiert sich an den Anforderungen der Kunden, insbesondere der Automobilindustrie sowie an den Bedürfnissen der Kunden nach Innovation, Qualität, Flexibilität und Liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich in der Struktur der ELMOS-Gruppe wider.

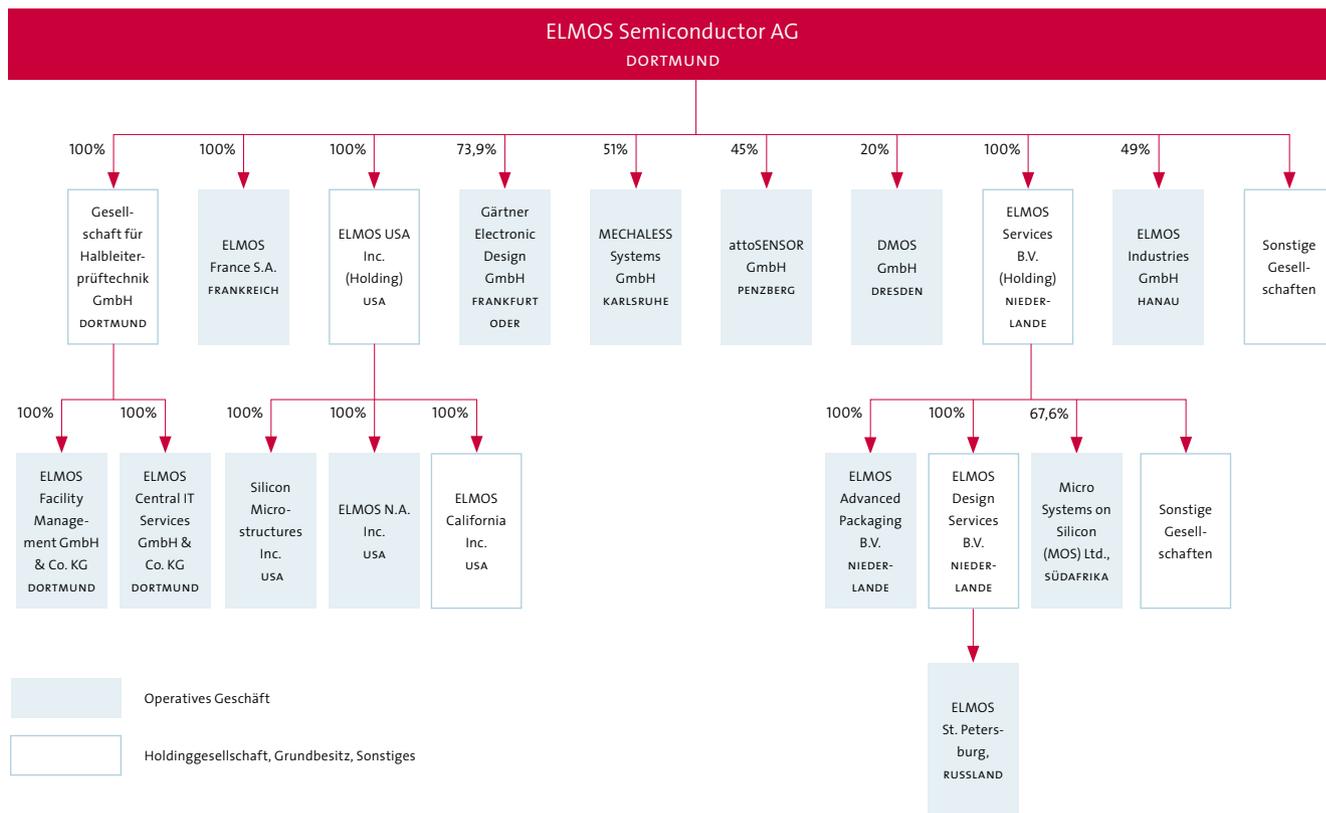
Diverse Niederlassungen, Tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden vor Ort. Neben den produzierenden Standorten in Dortmund, Duisburg, Nijmegen/Niederlande und Milpitas/Kalifornien/USA umfasst dies unter anderem die Niederlassungen in München und Stuttgart und die Tochtergesellschaften ELMOS France, ELMOS North America, MECHALESS, DMOS, GED und attoSensor. ELMOS France betreut Frankreich und Südeuropa und bietet Applikationsunterstützung und Customer Service vor Ort. Der französische Markt ist für ELMOS neben Deutschland die wichtigste Region. ELMOS North America bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz in Farmington Hills bei Detroit/USA aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie. In Asien ist ELMOS mit Repräsentanten in Japan und Korea vertreten.

Im Zuge des vermehrten Absatzes von ASSPs und nicht-automobilen Produkten vertreibt ELMOS ihre Produkte zusätzlich über verschiedene Distributoren. So wurde im Jahr 2007 die Vermarktung mit der Auswahl von zusätzlichen Distributoren auf neue Beine gestellt. Die ELMOS-Gruppe arbeitet nun mit zahlreichen Partnern in Europa und Asien zusammen. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Aufträgen aus der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterelektronik sowie der Medizintechnik. Die Distributoren zeichnen sich durch ein breites Kundenspektrum, großes Applikationsverständnis und hohe Zuverlässigkeit aus.

In der Segmentberichterstattung unterscheidet ELMOS zwischen den Bereichen Halbleiter und Mikromechanik. Das Segment Mikromechanik reflektiert die Geschäftstätigkeit von SMI. Die weiteren Gesellschaften und Aktivitäten werden im Segment Halbleiter geführt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9% größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG.



Rahmenbedingungen des automobilen Halbleitermarkts

Der für ELMOS wichtigste Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund 7% des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobilen Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie robuste Halbleitertechnologien.

In 2007 war die Basis unseres Kerngeschäfts – der Automobilssektor – in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, und in den USA schwach. Dies ist u.a. auf den Ölpreis, die in den USA ausgelöste Kreditkrise und deren Einfluss auf das Konsumverhalten sowie den schwachen Dollarkurs zurückzuführen. Dennoch konnten einige deutsche Automobilhersteller signifikante Erfolge im Export erzielen.

Basierend auf einer Studie des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI) wird in dem Zeitraum von 2006 bis 2011 insgesamt mit einer jährlichen Zunahme der Automobilproduktion um 4% gerechnet. Dabei schneiden Nordamerika und Deutschland mit mittleren jährlichen Produktionszunahmen zwischen 1% und 2% am schwächsten ab. Für Osteuropa und Asien werden signifikante Produktionszuwächse, zum Teil im zweistelligen Bereich, erwartet.

Wertanteil der Elektronik
am Auto: rund 22%

Während im Jahr 1985 bei einem PKW der Mittelklasse der Anteil elektronischer Systeme an den gesamten Produktionskosten nur 3% ausmachte, liegt heute dieser Wertanteil bereits bei etwa 22% des Produktionswertes. Gleichzeitig beträgt der Wert der Halbleiter etwa 12%. Aufgrund von zunehmender Integration elektronischer Systeme und wegen neuen Technologien wird erwartet, dass der Halbleiteranteil überproportional steigen wird. So soll der Wertanteil aller elektronischen Steuerungen im Fahrzeug bis Mitte der 2020er Jahre auf etwa 30% und der der Halbleiterbauelemente auf über 20% der Produktionskosten wachsen. Für die nächsten Jahre werden von verschiedenen Marktforschungsinstituten Wachstumsraten von 7% bis 8% pro Jahr für den automobilen Halbleitermarkt erwartet.

Treibende Faktoren:
Umweltschutz und Sicherheit

Treibende Elemente dieses Wachstums sind neben der stark weiter wachsenden Zahl von Dieselfahrzeugen mit aufwendiger Steuerung auch die neuen Benzinmotoren mit Hochdruck-Direkteinspritzung. Dazu kommen immer strenger werdende gesetzliche Abgasvorschriften, welche den Bedarf an aufwendigeren elektronischen Systemen verursachen. Großes Wachstum zeigen auch Systeme, die dem Personenschutz dienen, wie beispielsweise Fahrzeugstabilisierungssysteme.

ASICs sind auf einen festen
Kunden zugeschnitten

Der von ELMOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter (ASICs), und der applikationsspezifischen Halbleiter (ASSPs). Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche eine hohe Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten benötigen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. ASSPs unterscheiden sich insofern von ASICs, als dass diese von mehreren Kunden eingesetzt werden können, jedoch genau wie ASICs auf eine bestimmte Applikation zugeschnitten sind. Wettbewerber von ELMOS bei typischen ASIC- und ASSP-Projekten mit mittleren Stückzahlen sind Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, STMicroelectronics und Freescale.

Im Jahr 2007 hat sich der Trend der Vorjahre fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die so genannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Produktion



In 2007 wurden insgesamt rund 150 Millionen Chips produziert. Dabei hat sich der Trend der Vorjahre, steigende Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer), weiter fortgesetzt.

150 Millionen Chips
produziert

Die 2007 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden nach wie vor überwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) produziert. Die 200mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Produktionsstandort Duisburg wurde hochgefahren. Die Fertigung wurde am Jahresende 2007 noch nicht in der vollen Kapazität genutzt. Um Qualität und Stabilität von Produkten und Prozessen zu gewährleisten, haben wir in der zweiten Hälfte des letzten Quartals 2007 die Wafereinstellung nicht weiter gesteigert. Die zweite Halbleiterproduktionsstätte ist sowohl zur Absicherung der Versorgung als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotenziale aufgrund des größeren Waferdurchmessers bedeutend.

Erfreulich ist, dass im Laufe des Jahres 2007 ausreichend Kundenfreigaben zur Füllung der vorhandenen Kapazität am Standort Duisburg gewonnen werden konnten. Die in Duisburg gefertigten Produkte haben im Berichtsjahr einen wichtigen Beitrag zur Kundenversorgung geleistet. In 2008 wird der Ausbau in Duisburg fortgesetzt. Insbesondere werden Einzelinvestments zur Beseitigung von Maschinenengpässen und Schaffung von Redundanzen zur Volumenstabilisierung vorgenommen.

Ausbau des Standortes Duisburg
wird fortgesetzt

Der Fertigungsanteil von 8-Zoll-Wafern aus Duisburg soll weiter hochgefahren werden, so dass die nötige Kapazität für die Erweiterung und Umstellung der Fertigung am Hauptsitz in Dortmund planmäßig zur Verfügung stehen wird. Mitte 2008 soll dann mit der schrittweisen Umstellung der Produktionslinie in Dortmund von 6-Zoll auf 8-Zoll-Wafer begonnen werden. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten und zur Steigerung der Produktivität. Fertigungsflächen für die schrittweise Umstellung eines Teils der Dortmunder Waferfertigung auf 200mm-Waferdurchmesser sind vorhanden.

Im Jahresdurchschnitt 2007 lag die Maschinenkapazität insgesamt bei rund 580 Waferstarts pro Tag (6-Zoll-waferäquivalent). Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahresende 2006 (31. Dezember 2006: 480 Waferstarts pro Tag), welcher durch den Ausbau der Ferti-

Waferstarts pro Tag
stark gestiegen

gungslinie Duisburg begründet ist. Die durchschnittliche Ausnutzung mit rund 550 Waferstarts pro Tag ist ebenfalls stark gestiegen (2006: rund 430 Waferstarts pro Tag).

Neben den eigenen Fertigungsstätten soll zukünftig die erforderliche Kapazität auch durch Auftragsfertigungen (Foundries) bereitgestellt werden. Hierzu wurde nach Ende des Berichtsjahres bekannt gegeben, dass wir mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip kooperieren werden. Diese Kooperation ermöglicht es ELMOS, flexibel auch auf stärker schwankende Nachfrage reagieren zu können. Im Berichtsjahr wurde bereits mit einer taiwanesischen Foundry ein Konsumgüterprojekt gestartet und Prototypen produziert. Die Möglichkeit der Produktion bei einem Foundry-Partner soll insbesondere für ASSPs und für Produkte im Industrie- und Konsumgüterbereich wahrgenommen werden.

Das Standard-Assembly Geschäft wurde planmäßig Mitte 2007 komplett zu langjährigen Partnern nach Südostasien ausgelagert. Somit konzentriert sich die niederländische Tochtergesellschaft ELMOS Advanced Packaging nun schwerpunktmäßig auf die Tätigkeitsfelder Gehäuseentwicklung und Fertigung von Sondergehäusen für mikromechanische Systeme (MEMS), Waferbearbeitung und Verpackung (Tape & Reel).

Forschung und Entwicklung

Höchstmögliches Qualitätsniveau

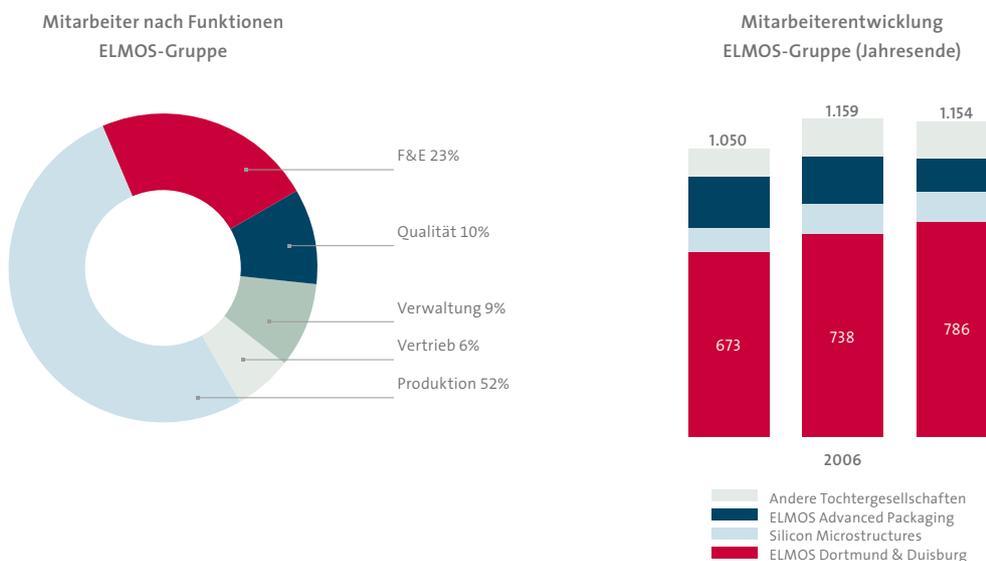
Die immer intensivere Nutzung von elektronischen Komponenten im Automobil führt zu kontinuierlich steigenden Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit bei Halbleitern in der Automobilelektronik. Um diesem Trend gerecht zu werden, nutzt ELMOS die Erfahrungen aus den Industrie- und Konsumgütermärkten für neue innovative Technologien als Innovationstreiber. ELMOS profitiert von diesem Sachverhalt z.B. indem in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen später im Automobil eingeführt werden und durch eigene – über die Standards hinausgehende – Qualifikationsverfahren abgesichert werden. Dies führt u.a. zu einem höchstmöglichen Qualitätsniveau auch bei neuen Produkten für das Automobil.

Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung die Entwicklung des 0,35µm Prozesses und das Starten der Prototyping-Phase dieses Prozesses. Die Fein-Optimierung und die Prozessintegration der am Standort Duisburg in Serie gefertigten Produkte wurden in 2007 ebenfalls intensiv vorangetrieben. Die Fertigung auf 200mm-Wafern bietet ELMOS die Möglichkeit, innovative und kostengünstige Lösungen mit Hilfe eigener Prozesstechnologien anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Inzwischen ist es Marktpraxis, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten vorfinanziert wird und sich über die Serienfertigung amortisieren muss. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von ASSP-Familien zu, die zukünftig einen größeren Umsatzanteil von ELMOS als in der Vergangenheit ausmachen werden. In Folge davon stiegen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. Euro auf 30,9 Mio. Euro an, entsprechend einer Quote von 17,5% vom Umsatz.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.



An ihren Standorten in Nordrhein-Westfalen hat ELMOS auch 2007 wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Zum Jahresende 2007 wurden in Dortmund und Duisburg 786 Mitarbeiter (31. Dezember 2006: 738) beschäftigt. Im Mittel stieg die Anzahl der Beschäftigten auch im Konzern in 2007 auf 1.177 (Jahresmittel 2006: 1.131). Zum Bilanzstichtag blieb die Zahl der im ELMOS-Konzern beschäftigten Mitarbeiter mit 1.154 in etwa auf Vorjahresniveau (31. Dezember 2006: 1.159). Zuwächse gab es vor allem im Bereich Qualität; demgegenüber stand der durch die Restrukturierung bedingte Personalabbau am Standort Nijmegen. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter lag 2007 bei 37 Jahren (2006: 36 Jahre), die Fluktuation bei rund 2%.

ELMOS bildet in zahlreichen kaufmännischen und technischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikrotechnologen. Ende 2007 befanden sich 56 (2006: 70) der Dortmunder Mitarbeiter in der Ausbildung. Viele der in 2004 anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums zusätzlich eingestellten Auszubildenden haben ihre Ausbildung in 2007 erfolgreich abgeschlossen.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Aus-

schüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden.

Das Stock Award Programm 2007 umfasste 29.000 Aktien, die zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurückerworben wurden. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil entstehen, beglichen werden können. ELMOS plant auch für die kommenden Jahren ein ähnliches Stock Award Programm.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz



Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS AP, SMI, ELMOS North America, GED, DMOS und die Fertigung in Duisburg wurden in 2007 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage | Auszug

Umsatzentwicklung

Das Jahr 2007 war durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnet. So spielten die Verunsicherung durch die in den USA ausgelöste Kreditkrise, der schwache US-Dollar und der hohe Ölpreis eine Rolle. Trotz dieser schwierigen Randbedingungen und der bei zwei Tochtergesellschaften durchgeführten Restrukturierung hat ELMOS mit einem Umsatzwachstum von 9,6% auf 176,1 Mio. Euro eine gute Leistung zeigen können. Die Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

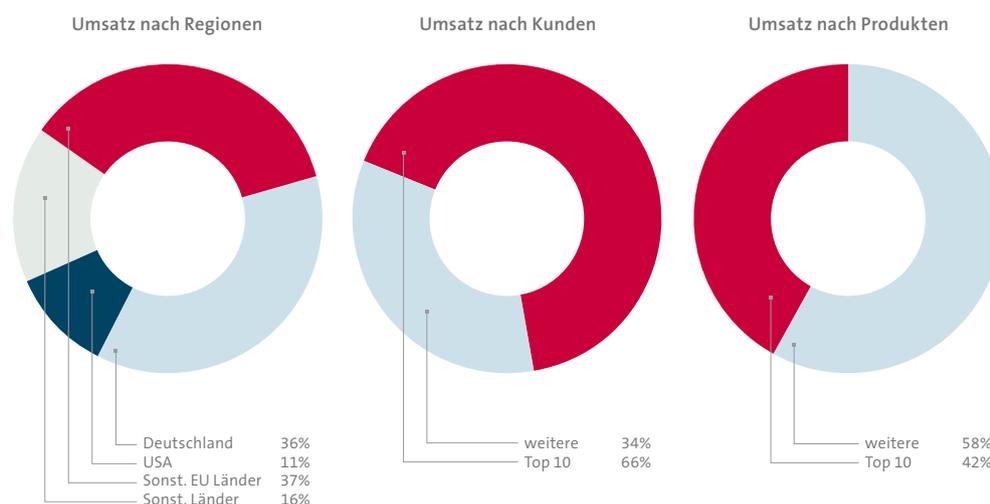
Umsatz nach Regionen

Die regionale Aufteilung des Umsatzes ist im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr. Der Deutschland-Anteil betrug 36,1% (2006: 37,4%), sonstige EU-Länder beliefen sich mit 36,7% (2006: 37,3%) auf ähnlichem Niveau. Während der Umsatz in den USA sowohl relativ als auch absolut leicht zurückgegangen ist und 10,9% (2006: 13,4%) ausmacht, gewannen die sonstigen Länder hinzu und trugen 16,3% (2006: 11,9%) zum Konzernumsatz bei. Länder mit Umsatzzuwachs sind vor allem Kanada, China, Mexiko, Schweiz und Taiwan. Die Veränderungen sind hauptsächlich auf den Wechsel einzelner Lieferadressen der Kunden bzw. den gesteigerten Umsatz mit bisherigen Kunden zurückzuführen und nicht gleichbedeutend mit einer Veränderung der Kundenstruktur.

Regionale Umsatzverteilung im Wesentlichen unverändert

Umsatz nach Kunden

ELMOS beliefert mehr als 100 Kunden. Dies sind überwiegend Automobilzulieferer und zu einem kleineren Anteil Industriekunden und Konsumprodukthersteller. In 2007 waren, wie in früheren Jahren, der französische Automobilzulieferer Valeo, die schwedische Autoliv und die Schweizer Saia-Gruppe unsere größten Kunden, die jeweils mehr als 10% des Umsatzes ausgemacht haben. Der mit unseren größten Kunden getätigte Umsatz verteilt sich in der Regel auf zahlreiche unterschiedliche Produkte, die sich in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklusses befinden. Die zehn größten Kunden machten in 2007 fast unverändert rund 66% (2006: 68%) oder zwei Drittel unseres Umsatzes aus.



Ertragslage

Die Ergebnisse des Berichtsjahres sind – wie im April 2007 angekündigt – geprägt durch die Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 5,7 Mio. Euro.

Bruttoergebnis

Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte durch Restrukturierungen stieg das Bruttoergebnis unterproportional zum Umsatz um 5,2% auf 76,9 Mio. Euro (2006: 73,0 Mio. Euro). Dies entsprach einer Bruttomarge von 43,6% vom Umsatz (2006: 45,5%). Sie wurde vor allem durch erhöhte Aufwendungen beim Aufbau des neuen Fertigungsstandortes in Duisburg beeinträchtigt, was zu einem Anstieg der Herstellungskosten von 87,6 Mio. Euro in 2006 um 13,3% auf 99,3 Mio. Euro in 2007 führte.

Unter Berücksichtigung der Sondereffekte belief sich das Bruttoergebnis auf 73,1 Mio. Euro und die Bruttomarge betrug dementsprechend 41,5%. Daran zeigt sich, dass der Großteil der Restrukturierungsaufwendungen (3,8 Mio. Euro) in den Herstellungskosten erfasst ist.

Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen) und EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)

ASSP-Entwicklung
intensiviert

Unser Engagement in der Entwicklung von Standardprodukten (ASSPs), insbesondere zum Ende des Geschäftsjahres, haben wir weiter intensiviert. Zudem haben wir die Entwicklung der nächsten Technologiegeneration beschleunigt. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen stiegen auch deswegen auf 30,7 Mio. Euro, blieben mit einem Anstieg von 3,9% jedoch deutlich unter dem Umsatzwachstum. Sie unterstreichen mit ihrem Anteil von 17,5% vom Umsatz (2006: 18,4%) jedoch nach wie vor die hohe Bedeutung der Produktentwicklung und -innovation für ELMOS als Technologieunternehmen. Die Marketing- und Vertriebsaufwendungen kletterten überproportional zum Umsatz auf 11,6 Mio. Euro. Dies ist auf die erhöhten Anstrengungen bei ASSPs im Allgemeinen, der verstärkten Akquisition im Industrie- und Konsumgüterbereich und den erfolgreichen Markteintritt in Asien zurückzuführen. Die Aufwendungen für Allgemeine Verwaltung wuchsen in etwa umsatzproportional auf 15,2 Mio. Euro (alle Zahlen ohne Sondereffekte).

Ohne Sondereffekte blieb das Betriebsergebnis bei 19,3 Mio. Euro in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (2006: 19,6 Mio. Euro). Im Vergleich zu 2006 war die Bruttomarge wie oben erläutert um knapp zwei Prozentpunkte niedriger. Die in Prozent vom Umsatz etwas geringeren funktionalen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 32,7% vom Umsatz (2006: 33,3%) führten dazu, dass die Betriebsergebnis-Marge mit 11,0% vom Umsatz (2006: 12,2%) sich nicht so stark reduzierte wie die Bruttomarge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden im Wesentlichen beeinflusst (4,8 Mio. Euro) durch die Umstrukturierung eines bestehenden Leasingvertrags aufgrund des Ablaufs der ersten Zinsbindungsfrist. Dieser bisher als Finanzierungsleasing erfasste Vertrag wurde per Ende 2007 in eine operative Leasingstruktur überführt. Der daraus resultierende Effekt war vom Grundsatz und der ungefähren Höhe nach in der Planung für das Geschäftsjahr 2007 bereits enthalten.

Das EBIT unterscheidet sich vom Betriebsergebnis durch die zusätzliche Berücksichtigung von Wechselkursverlusten/(-gewinnen), Aufwendungen/(Erträgen) aus assoziierten Unternehmen

und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen). Das EBIT stieg auf 20,9 Mio. Euro (2006: 19,8 Mio. Euro) bzw. betrug 11,8% vom Umsatz (2006: 12,3%).

Die Sondereffekte hatten bei den funktionalen Aufwendungen Einfluss auf Forschung und Entwicklung (0,2 Mio. Euro) und Allgemeine Verwaltung (0,9 Mio. Euro). Die Position Sonstiger Aufwand wurde zusätzlich um 0,8 Mio. Euro belastet.

Die Restrukturierungsaufwendungen belasteten die Kennzahlen, wie prognostiziert, um rund drei Prozentpunkte. Das Betriebsergebnis unter Berücksichtigung der Sondereffekte betrug 14,5 Mio. Euro oder 8,2% vom Umsatz und das EBIT 15,2 Mio. Euro oder 8,6% vom Umsatz.

Belastungen durch
Einmaleffekte

Ergebnis vor Steuern, Konzernüberschuss und Ergebnis pro Aktie

Die Finanzierungserträge/-aufwendungen stiegen in 2007 auf 3,0 Mio. Euro (2006: 2,5 Mio. Euro). Der Anstieg ist im Wesentlichen begründet durch ein in 2007 höheres Zinsniveau als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 3,3% auf 17,9 Mio. Euro oder 10,2% vom Umsatz (2006: 17,3 Mio. Euro bzw. 10,8%). Unter Berücksichtigung der Sondereffekte betrug das Ergebnis vor Steuern 12,2 Mio. Euro bzw. 6,9% vom Umsatz.

Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte beliefen sich die Steueraufwendungen auf 5,6 Mio. Euro und waren damit 15,6% geringer als im Vorjahr (2006: 6,6 Mio. Euro). Die Steuerquote hätte demnach 31,3% betragen. Aufgrund der Restrukturierungsaufwendungen ist die Steuerlast um 45,8% niedriger als im Vorjahr ausgefallen und betrug 3,6 Mio. Euro, resultierend in einer Steuerquote von 29,4%. In beiden Fällen ist die Steuerquote unterhalb der vom Vorjahr (2006: 38,4%). 2006 war beeinflusst durch eine Änderung des niederländischen Steuerrechts, wodurch latente Steuern erfolgswirksam wurden. In 2007 ist ein positiver Effekt aus der Absenkung der Steuersätze in Deutschland im Rahmen der Unternehmensteuerreform in Höhe von 1,2 Mio. Euro enthalten.

Ohne Sondereffekte betrug der Jahresüberschuss nach Minderheitenanteilen 12,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 16,4% im Vergleich zum Vorjahr (2006: 10,7 Mio. Euro) entspricht. Die Nettogewinnmarge liegt somit mit 7,1% oberhalb des Wertes aus 2006 (6,7%). Folglich konnte das Ergebnis je Aktie auf 0,64 Euro deutlich gesteigert werden (2006: 0,55 Euro).

Unter Berücksichtigung der Restrukturierungsaufwendungen sank der Jahresüberschuss nach Minderheitenanteilen auf 8,8 Mio. Euro bzw. der Gewinn pro Aktie betrug 0,45 Euro.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Der Jahresfehlbetrag der ELMOS Semiconductor AG* gemäß HGB betrug 5,3 Mio. Euro in 2007. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2006 beläuft sich auf 44,9 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, am 8. Mai 2008 zu beschließen, den Bilanzgewinn in Höhe von 39,6 Mio. Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Trotz der Verbesserung der Liquiditätslage gegenüber dem Vorjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor dem Hintergrund der durch die Sondereffekte aus der Restrukturierung belasteten Ergebnisse vor, keine Dividende auszuschütten. Die Gesellschaft hält daran fest, eine Dividende zu zahlen, wenn Ergebnisentwicklung und Cash Flow nachhaltig positiv sind.



* Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen. Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim Unternehmensregister hinterlegt und kann als Sonderdruck angefordert werden.

Finanzlage

Cash Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit erhöht

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Nach einem bereits signifikant verbesserten Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in 2006 in Höhe von 28,5 Mio. Euro, konnte dieser in 2007 erneut um 2,3 Mio. Euro oder 7,9% auf 30,8 Mio. Euro gesteigert werden. Dieses war trotz des niedrigeren Jahresüberschusses möglich, der durch die Restrukturierungen beeinflusst war. Die wesentlichen Gründe dafür sind, dass die Restrukturierungsaufwendungen nicht vollständig cash-wirksam waren, nicht so hohe Steuern bezahlt wurden wie im Vorjahr, sonstige Forderungen zurückgegangen sind sowie ein gewährtes Darlehen zurückgezahlt worden ist. Diese positiven Auswirkungen konnten sogar den stark gegenläufigen Effekt der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen/Erträge (Unterschied von 9,6 Mio. Euro) mehr als ausgleichen. Während diese Position in 2006 positiv zum operativen Cash Flow (5,5 Mio. Euro) beigetragen hat, war im Berichtsjahr per Saldo ein Ertrag in Höhe von 4,1 Mio. Euro nicht cash-wirksam und wurde entsprechend rückgerechnet. Dieser nicht liquiditätswirksame Ertrag ist im Wesentlichen auf die Umstrukturierung eines Leasingvertrags für ein Wirtschaftsgut zurückzuführen, welches vom Finanzierungsleasing in eine operative Leasingstruktur überführt wurde.

Investitionen
reduziert

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

Nach dem Rückgang der Investitionen in 2006 wurden diese in 2007 nochmals reduziert und betrugen 24,5 Mio. Euro – trotz des weiteren Ausbaus der Fertigungskapazitäten. In Prozent vom Umsatz sanken diese von 16,4% in 2006 auf 13,9% im Berichtsjahr. Die Investitionen entfielen vor allem auf die Ausstattung des Reinraums am Standort Duisburg sowie auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen für das Dortmunder Frontend und Backend. Das Halbleiter-Segment war mit 23,8 Mio. Euro für den größten Teil der Investitionen verantwortlich, auf die Mikromechanik entfielen 0,7 Mio. Euro.

Die zur Weiterveräußerung gehaltenen Vermögenswerte wurden in 2007 planmäßig im Rahmen von Sale-and-Lease-back-Transaktionen verkauft. Darüber hinaus wurde ein Leasingvertrag, der bislang als Finanzierungsleasing dargestellt wurde auf eine operative Leasingstruktur umgestellt. Diese Effekte haben dazu geführt, dass der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit mit 23,1 Mio. Euro positiv beeinflusst wurde. Insgesamt entstand ein Cash Bedarf aus der Investitionstätigkeit von 1,4 Mio. Euro.

Free Cash Flow
deutlich gesteigert

Als Resultat des gestiegenen operativen Cash Flows und des geringeren Bedarfs an Cash aus der Investitionstätigkeit konnte der Free Cash Flow in 2007 deutlich auf 29,4 Mio. Euro gesteigert werden (2006: 8,6 Mio. Euro). Auch bei Nicht-Berücksichtigung des Barmittelzuflusses aus den Veräußerungen der Vermögensgegenstände und sonstiger Einflussfaktoren auf den Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit konnte noch immer ein beachtlicher Betrag an freiem Cash in Höhe von 6,3 Mio. Euro (2006: 2,2 Mio. Euro) generiert werden.

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Durch die Umstellung des Leasingvertrags von Finanzierungsleasing auf eine operative Leasingstruktur wurden die entsprechenden überwiegend langfristigen Finanzverbindlichkeiten (16,3 Mio. Euro) ausgebucht. Darüber hinaus führte die Umfinanzierung von kurzfristigen in lang-

fristige Verbindlichkeiten im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit dazu, dass sich insgesamt eine Nettoabnahme von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,9 Mio. Euro ergab. Die Umfinanzierung stärkt die Unabhängigkeit der Gesellschaft in Bezug auf schwankende Zinssätze.

Im Wesentlichen als Folge des hohen Free Cash Flows konnten die Zahlungsmittel und -äquivalente von 16,6 Mio. Euro Ende 2006 auf 42,9 Mio. Euro am 31. Dezember 2007 gesteigert werden. Der Anteil der liquiden Mittel am Gesamtvermögen kletterte damit auf 17,2% (31. Dezember 2006: 6,8%).

Vermögenslage

Die Darstellung der latenten Steuern wurde erstmalig in 2007 (und rückwirkend für 2006) auf die Bruttomethode umgestellt, was zu einer Bilanzverlängerung führte. Die Bilanzsumme der ELMOS-Gruppe stieg von 245,3 Mio. Euro im Jahr 2006 um 1,6% auf 249,3 Mio. Euro in 2007.

Bilanzsumme
erhöht

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind neben dem signifikanten Anstieg der Cash-Position der Rückgang der Position Gebäude und Einbauten (Abgang eines bisher als Finanzierungsleasing erfassten Wirtschaftsgutes), die Verminderung der Position von zur Veräußerung gehaltenen Wirtschaftsgütern (Erweiterung des Produktionsgebäudes in Dortmund) und die Abnahme sonstiger Vermögenswerte. Auf der Passivseite sind als Vorgänge von besonderer Bedeutung lediglich die oben erwähnte Umfinanzierung von kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten, die Umstellung eines Vertrages von Finanzierungsleasing auf eine operative Leasingstruktur sowie die Veränderung bei den passiven latenten Steuern zu nennen.

Nettoumlaufvermögen

Die Vorräte stiegen unterproportional zum Umsatz um 7,9% auf 33,6 Mio. Euro am 31. Dezember 2007. Damit stieg der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen im Vergleich zu 2006 leicht von 12,7% auf 13,5%. Durch kontinuierlich verbessertes Forderungsmanagement wuchsen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 2,3% weniger als der Umsatz auf 28,4 Mio. Euro (31. Dezember 2006: 27,8 Mio. Euro). Damit konnte auch die Umschlagshäufigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 5,8x auf 6,2x des Umsatzes verbessert werden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 14,6% auf 14,6 Mio. Euro am Ende des Berichtsjahres. Die Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen zeigt sich in dem nur leichten Anstieg des Nettoumlaufvermögens auf 47,4 Mio. Euro (31. Dezember 2006: 46,2 Mio. Euro).

Forderungsmanagement
weiter verbessert

Passiva

Die Nettoverschuldung sank zum Bilanzstichtag 2007 auf 11,1 Mio. Euro, ein Rückgang um 77,0%. Die Finanzverbindlichkeiten sind im Jahresvergleich geringer geworden (54,0 Mio. Euro am 31. Dezember 2007 gegenüber 65,0 Mio. Euro am 31. Dezember 2006); vor allem aber sind die liquiden Mittel signifikant auf 42,9 Mio. Euro gestiegen. Ins Leasing gegebene sowie veräußerte Vermögenswerte haben einerseits zu einer Verbesserung der Cash-Position beigetragen, haben jedoch andererseits zu einem Anstieg der sonstigen finanziellen Verpflichtungen geführt.

Nettoverschuldung
gesunken

Das Eigenkapital stieg von 152,3 Mio. Euro auf 160,0 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote wuchs ebenfalls auf 64,2% (31. Dezember 2006: 62,1%).

Prognosebericht

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Mittelfristig erwarten Marktforschungsinstitute Wachstumsraten von rund 7% bis 8% pro Jahr für den automobilen Halbleitermarkt. Dabei spielt nach wie vor der anhaltende Wachstumstrend der Elektronik im Automobil eine größere Rolle als eine Veränderung der Produktionszahlen in der Automobilindustrie. So soll der Elektronikanteil im Automobil stetig steigen.

Im Jahr 2008 spielen die Unsicherheiten über den weiteren Fortgang der Ereignisse am Immobilienmarkt in den USA und an den internationalen Finanzmärkten eine Rolle und überschatten den wirtschaftlichen Ausblick. Darüber hinaus hat die Entwicklung des Ölpreises einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Wir erwarten, dass das Marktumfeld nach wie vor schwierig bleiben wird.

Ausblick der ELMOS-Gruppe

ELMOS will in 2008 ihre Position als führendes Unternehmen der automobilen Halbleiterbranche ausbauen, gleichzeitig aber auch stärker in neue Märkte vordringen. ELMOS profitiert von der in 2007 gelegten Basis und wird sich in 2008 insbesondere auf die folgenden Themen konzentrieren:

- ▶ Optimierung des Standorts Duisburg
- ▶ Start der teilweisen Umstellung der Fertigung in Dortmund von 6-Zoll auf 8-Zoll
- ▶ Verbesserte Nutzung der Marktchancen für Mikrosysteme
- ▶ Vermehrter Vertrieb von ASSPs
- ▶ Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Optimierung des Produktportfolios und Reduktion der Investitionen
- ▶ Steigerung der Aktivitäten in Neuen Märkten (Industrie- und Konsumgütermärkte, Asien)

Gegen den Markttrend konnte ELMOS in 2007 ihre Prognose für das Berichtsjahr bekräftigen und erfüllen und auch für 2008 einen soliden Ausblick kommunizieren. Dies ist unter anderem das Resultat der in den vergangenen Jahren geleisteten Verbesserungen im Rahmen der Qualitätsinitiative und daraus folgendem Vertrauen, welches die Kunden in ELMOS setzen.

Für das Jahr 2008 bestätigen wir unsere Prognose aus November 2007. Dementsprechend rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von 7% bis 9%. Für die EBIT-Marge wird eine Steigerung auf 12% bis 14% vom Umsatz erwartet. Die Investitionen sollen gegenüber 2007 sinken; der Free Cash Flow soll demnach positiv ausfallen. Diesem Ausblick liegt die Annahme eines Wechselkurses von 1,40 US-Dollar je Euro zugrunde. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich der Auftragseingang entsprechend der durch unsere Kunden gemachten Prognosen realisiert.

Dortmund, im März 2008

Der Vorstand



Dr. Anton Mindl



Nicolaus Graf von Luckner



Reinhard Senf



Dr. Frank Rottmann

Jahresabschluss

Konzernbilanz nach IFRS

Aktiva	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Langfristige Vermögenswerte		
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.108.968	39.754.707
Sachanlagen	86.984.152	96.289.500
At-Equity bewertete Beteiligungen	1	2
Wertpapiere und Anteile	73.932	126.154
Latente Steueransprüche	8.105.939	8.155.999
Summe langfristige Vermögenswerte	137.272.992	144.326.362
Kurzfristige Vermögenswerte		
Vorratsvermögen	33.613.927	31.142.235
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.406.265	27.774.401
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	42.855.617	16.634.086
Sonstige Vermögenswerte und Ertragsteueransprüche	6.550.185	12.122.346
	111.425.994	87.673.068
Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird	625.877	13.343.658
Summe kurzfristige Vermögenswerte	112.051.871	101.016.726
Bilanzsumme	249.324.863	245.343.088

Passiva	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Eigenkapital		
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital		
Grundkapital	19.414.205	19.413.805
Kapitalrücklage	88.736.563	88.733.815
Gewinnrücklagen	102.224	102.224
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals	-6.407.297	-5.587.888
Bilanzgewinn	57.809.788	49.091.408
	159.655.483	151.753.364
Minderheitenanteil	309.704	505.088
Summe Eigenkapital	159.965.187	152.258.452
Schulden		
Langfristige Schulden		
Rückstellungen	1.111.214	1.142.637
Finanzverbindlichkeiten	51.622.281	28.284.983
Sonstige Verbindlichkeiten	2.533.246	354.307
Latente Steueransprüche	4.575.409	4.026.769
Summe langfristige Schulden	59.842.150	33.808.696
Kurzfristige Schulden		
Rückstellungen	6.110.536	5.122.981
Steuerverbindlichkeiten	1.879.590	280.169
Finanzverbindlichkeiten	2.343.009	36.712.756
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.589.724	12.731.544
Sonstige Verbindlichkeiten	4.594.667	4.428.490
Summe kurzfristige Schulden	29.517.526	59.275.940
Summe Schulden	89.359.676	93.084.636
Bilanzsumme	249.324.863	245.343.088

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

	2007 Euro	2006 Euro
Umsatzerlöse	176.133.528	160.673.887
Umsatzkosten	103.024.409	87.629.925
Bruttoergebnis	73.109.119	73.043.962
Forschungs- und Entwicklungskosten	30.892.815	29.583.236
Vertriebskosten	11.610.720	9.679.254
Verwaltungsaufwendungen	16.136.701	14.216.140
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen)	14.468.883	19.565.332
Finanzierungserträge	– 822.450	– 452.319
Finanzierungsaufwendungen	3.793.824	2.954.883
Wechselkursverluste	381.093	288.115
Aufwendungen (Erträge) aus assoziierten Unternehmen	– 48.999	48.999
Sonstige betriebliche Erträge	– 9.312.235	– 5.834.782
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.240.100	5.239.685
Ergebnis vor Steuern	12.237.550	17.320.751
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Ertragsteueraufwand	2.994.630	1.185.589
Latente Steuern	609.012	5.458.781
	3.603.642	6.644.370
Konzernüberschuss	8.633.908	10.676.381
Davon entfallen auf:		
Minderheitenanteile	– 163.809	– 18.291
Anteilseigner des Mutterunternehmens	8.797.717	10.694.672
Ergebnis je Aktie		
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,45	0,55
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,45	0,55

Konzern-Kapitalflussrechnung

	2007 Euro	2006 Euro
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit		
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen	8.797.717	10.694.672
Abschreibungen	19.599.904	16.287.270
Nicht liquiditätswirksamer Ertrag/Aufwand	– 4.147.108	5.458.781
Ertragssteueraufwand	2.994.630	1.185.589
Minderheitenanteile	– 163.809	– 18.291
Ertrag/Aufwand aus der Bewertung At-Equity	– 48.999	48.999
Veränderung der Pensionsrückstellungen	– 31.423	20.933
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm	0	453.611
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	– 631.863	1.296.722
Vorräte	– 2.471.692	– 3.437.645
Rechnungabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände	5.700.957	– 1.907.421
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.817.694	2.157.383
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	840.051	– 834.160
Ertragsteuerzahlungen	– 1.472.368	– 2.886.707
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit	30.783.691	28.519.736
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit		
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	– 7.272.751	– 9.578.886
Investitionen in das Sachanlagevermögen	– 17.214.995	– 16.772.554
Abgang/Investitionen in zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	12.717.781	– 7.346.464
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.309.057	10.198.918
Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	3.629.862
Abgang/Erwerb von Beteiligungen	68.523	– 45.723
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	– 1.392.384	– 19.914.847
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlung aus Kapitalerhöhung	3.148	10.868
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	42.853.306	325.000
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	– 14.794.111	– 5.674.655
Tilgung/Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	– 31.954.157	1.266.460
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	– 3.891.814	– 4.072.327
Abnahme/Zunahme der liquiden Mittel	25.499.493	4.532.562
Effekt aus Wechselkursänderungen der liquiden Mittel	722.038	682.884
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	16.634.086	11.418.640
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	42.855.617	16.634.086

Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals nach IFRS

	Aktien Stück	Grund- kapital Euro	Kapital- rücklage Euro
Stand 1. Januar 2006	19.412.424	19.412.424	88.270.716
Aufwand aus Aktienoptionen			453.611
Ausübung von Optionen	1.381	1.381	9.487
Nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern			
Währungsveränderungen			
Änderung des Konsolidierungskreises			
Jahresüberschuss 2006			
Stand 31. Dezember 2006	19.413.805	19.413.805	88.733.815
Ausübung von Optionen	400	400	2.748
Währungsveränderungen			
Änderung des Konsolidierungskreises			
Jahresüberschuss 2007			
Stand 31. Dezember 2007	19.414.205	19.414.205	88.736.563

Gewinn- rücklagen Euro	Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals Euro	Bilanz- gewinn Euro	Gesamt Euro	Minder- heitenanteil Gesamt Euro	Konzern Gesamt Euro
102.224	- 2.943.060	38.912.998	143.755.302	528.190	144.283.492
			453.611		453.611
			10.868		10.868
	- 1.211.241		- 1.211.241		- 1.211.241
	- 1.433.587		- 1.433.587		- 1.433.587
		- 516.262	- 516.262	- 4.811	- 521.073
		10.694.672	10.694.672	- 18.291	10.676.381
102.224	- 5.587.888	49.091.408	151.753.364	505.088	152.258.452
			3.148		3.148
	- 819.409		- 819.409		- 819.409
		- 79.337	- 79.337	- 31.575	- 110.912
		8.797.717	8.797.717	- 163.809	8.633.908
102.224	- 6.407.297	57.809.788	159.655.483	309.704	159.965.187

Finanzkalender

13. März 2008	Bilanzpressekonferenz ELMOS Dortmund
13. März 2008	Analystenkonferenz Frankfurt am Main
30. April 2008	Zwischenbericht Januar bis März 2008
8. Mai 2008	Hauptversammlung Casino Hohensyburg, Dortmund
13. August 2008	Zwischenbericht Januar bis Juni 2008
5. November 2008	Zwischenbericht Januar bis September 2008

Kontakt

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund
www.elmos.de

Investor Relations | Janina Rosenbaum
Telefon +49 (0) 231-75 49-287
Telefax +49 (0) 231-75 49-548
invest@elmos.de

Den vollständigen Geschäftsbericht
können Sie bei oben genannter
Kontaktadresse kostenlos anfordern
oder von unserer Homepage
herunterladen.